



## Pasta para Soldar 42gr XGSP50 MECHANIC

### Descripción

### CARACTERÍSTICAS

- Aplíquese con pincel, directo al dispositivo en reparación.
- Evita la oxidación de las pistas de cobre en circuitos impresos y permite obtener soldaduras brillantes y confiables.
- Durante el soldado, disminuye la tensión superficial del estaño y la temperatura de fusión, evitando el deterioro de componentes, trazas, terminales y conectores en general.
- No sobrecalentar, se puede destruir el flux y el cobre perdería sus propiedades mecánicas.
- Ideal para microelectrónica con soldaduras sin plomo.
- Debe utilizarse en equipos apagados.

### VENTAJAS

- Reduce el óxido en los componente y superficies aplicadas.
- Reduce la tensión superficial de la soldadura fundida.
- Ayuda a prevenir la oxidación de la superficie durante y después de la soldadura.
- Mejora la transferencia de calor entre la superficie a soldar, obteniendo así una mejor calidad den el trabajo.

### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	XGSP50
<b>MARCA</b>	MECHANIC

---

<b>TIPO</b>	Pasta para Soldar
<b>CONTENIDO</b>	42 gramos
<b>PUNTO DE FUSIÓN</b>	183°C
<b>ALEACIÓN</b>	Estaño 63%/Plomo 37% (Sn63/Pb37)
<b>MICRAS</b>	20-38um

*mihaba.com*